|  |  |
| --- | --- |
| **氏名** |  |
| **専門分類（業務経験上で特に専門とされる分類に○を付けて下さい。）※複数回答可** |
| **大分類** | 半導体パッケージ | サブストレート | プリント配線板（リジッド・フレキ） |  |
| 設計 | 製造 | 実装 | 品質管理 |  |  |  |
| 経営 | 営業 | 調達 | 工場設営 |  |  |  |
| **小分類** | 設計：部品データ設計（基板構造含む）、配線設計、CAM出力、シミュレーション　等製造：資機材（材料、薬剤、装置）、TH加工（穴あけ、めっき）、表面処理（OSP、金めっき）、製造技術、生産技術　等実装：電子部品、搭載・接合技術　等品質管理：検査技術、信頼性評価技術、各種解析技術、問題解決手法、品質管理手法、クレーム対策技術　等半導体プロセス：前工程、後工程　等経営：経営管理、生産管理、情報システム　等営業：マーケティング、技術営業　等調達：設備調達、材料・部品調達　等工場設営：基板製造装置設計、設備仕様設計　等その他（　　　　　　） |

**レジュメ（経歴及び今後の活動内容）**

1. これまで経験した業務の中で、自身が一番貢献できたものは何ですか。

２．現在取り組んでいる課題は何ですか。

３．後進（部下及び後輩）の指導をどのようにしていますか。

**以下の項目について記述下さい。**

**レジュメ作成時の注意事項**

1～3の設問において思うところをA4サイズ1枚にまとめて下さい。

また、別紙に今後の活動内容についてA4サイズ1枚にまとめて下さい。

ご記入にあたっては、日本語（フォントサイズ‘10.5’）をご使用下さい。

★この注意項目は、レジュメ作成時に除去して下さい。

**今後の活動内容について**